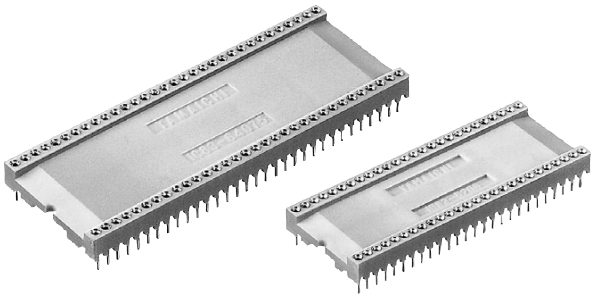
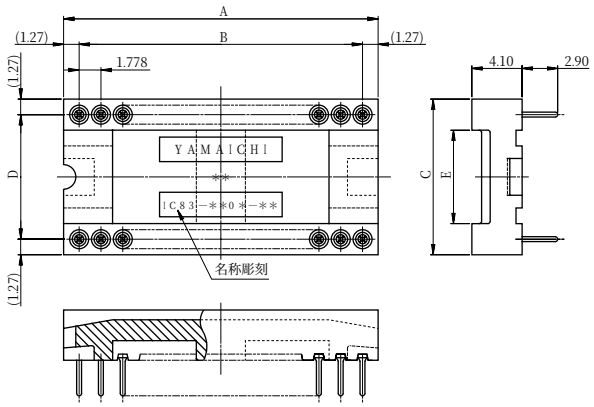
IC 83 SERIES DIP(Shrink 1.778mm pitch)



●寸法図



特　徴

- 高密度実装用シュリンクピッチ（1.778mm）ソケット。
- 4枚バネによる高信頼性丸ピンコンタクト。

仕　様

性能

絶縁抵抗	1,000MΩ以上（at DC500V）
耐電圧	AC700V rms 1分間
接触抵抗	20mΩ以下（at 10mA）
定格電流	1A
使用温度	−65℃ ～ +125℃

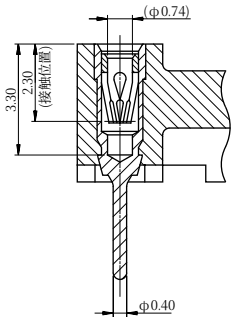
材質

絶縁体	PET樹脂ガラス入り、UL94V-0
コンタクト	インナーコンタクト：銅合金、ニッケル下地金めっき または錫めっき アウタースリーブ：銅合金、半田めっきまたは金めっき

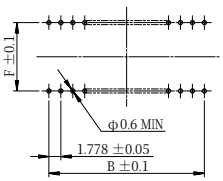
適合リード

矩形リード	$0.5^{+0.1}_{-0.12}$ W×$0.25^{+0.15}_{-0.05}$ t、ただし断面の対角線寸法は0.63以下
丸形リード	φ$0.5^{+0.13}_{-0.1}$

●接触部詳細図



●プリント板レイアウト（参考値）
（TOP VIEW）



品名表示方法

IC83—64075—GS4

- IC83シリーズ
- 芯数
- IC端子列間隔　75＝0.75インチ
- 接触部めっき仕様　G＝金めっき　S＝錫めっき
- 端子部めっき仕様　S＝半田めっき　G＝金めっき
- ストレート半田ディップ端子

品　名	芯数	A	B	C	D	E
IC83—2804 —＊＊4	28	25.654	1.778×13＝23.114	12.70	10.16	7.62
IC83—3204 —＊＊4	32	29.210	1.778×15＝26.670	12.70	10.16	7.62
IC83—4206 —＊＊4	42	38.100	1.778×20＝35.560	17.78	15.24	12.70
IC83—4806 —＊＊4	48	43.434	1.778×23＝40.894	17.78	15.24	12.70
IC83—5206 —＊＊4	52	46.990	1.778×25＝44.450	17.78	15.24	12.70
IC83—5406 —＊＊4	54	48.768	1.778×26＝46.228	17.78	15.24	12.70
IC83—64075—＊＊4	64	57.658	1.778×31＝55.118	21.59	19.05	16.51

単位（mm）

ご使用上の注意

製品をご使用になる前に本カタログ、その他の取扱説明書に記載された内容をよくお読みの上、正しくお使いください。

●本カタログに掲載されている製品は、情報事務機器、通信機器、計測機器、FA機器、IC評価機器(テスト/バーン・イン)等に使用される目的で設計されております。その他の用途(注1)、特殊な条件下でのご使用(注2)をご検討の際には、事前に当社までお問い合わせください。

(注1)「その他の用途」事例：航空宇宙機器、原子力発電機器、軍事用機器、医療用機器等

(注2)「特殊な条件下でのご使用」事例：高温環境下、高湿環境下、減圧環境下等

●製品のお取り扱いには十分ご注意ください。

特に素手で製品を取り扱うと、製品の性能が劣化する恐れがあるだけでなく、製品の端子部分等によりけがをする恐れがあります。

その他、製品の使用中に何らかの異常を感じた場合には、直ちに使用を中止し、当社までご連絡ください。

●本カタログ記載の注意は、貴社の従業員、委託先、販売店、消費者その他、製品を単独または他の製品の一部として使用するすべての方によって、守られるようにしてください。貴社または上記の第三者が、本カタログ記載の注意に従わず製品を使用した結果生じた生命、身体または財産の損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。

●実装用ICソケットおよび測定用ICソケットの章に掲載している、適合IC寸法に関する情報はあくまでも参考値です。製品の使用をご検討の際には当社までお問い合わせください。

●本カタログに記載されている内容は、製品の改良等のために予告無く変更されることがあります。製品をご使用になる際には、事前に製品の最新図面をご要求ください。